

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商局资本：张倩倩；北汽产业投资：黄珍妮；财信产业基金：廖攀；复星创富：刘妍；山东国惠：徐庆瑞；青岛城投：任怡；上海大正投资：张璟；西安投资：索佳明；四川璞信：叶帆；山东铁投：刘虔；南航资本：杨浩；南方工业：吴言一；建投投资：王粟；新华资产：舒良；诺德基金：尹旻；招商银行：郭亮；建投资管：陈友章；第一创业：何羽立；中金资管：高亦安；兴证资管：杨亦；中信自营：李建伟；财达证券：张瑞旺；湘财证券：巢枫；广发证券：林力；招商证券：范宏超；义乌和谐：江舸；上海同安投资：林桢景；深圳纽富斯：杨雪香；吉富创业：王誉轩；宁波平方和：史建；东方光石：刘子瑜；上海明泓：刘楠；深圳思为：费伊茗；上海睿亿：黄文昊；上海朗实：姚传法；中冀投资：鞠永刚；盈科资本：范曦临；龙马资本：何晶；中和资本：管万强；上海盛宇投资：石先志；瑞世控股：袁通；嘉石大岩：黄帆；颐和银丰：杨勇；常瑜基金：卢伟；金章投资：张烁；磐厚投资：钱监亮；华章天地投资：胡博；通怡资产：沈嘉迪；厦门信息资本：林小池；城泰基金：马跃峰；达晨投资：高尚；韶夏资本：叶柱良；上海投觉：成晓清；迎水投资：宋诚菲；朗实投资：王磊；博芮投资：赵瑾；泸州老窖集团：宋育鹏；君和资本：王瑞思；光大永明人寿：刘冰；北京国际

	<p>信托：赵瑶明；德贝瑞资产管理：高鹏；上海乘舟投资：韩小倩；上海建工集团投资：潘可中；兴业基金：贾茹；上海毓实投资：韩玉清；财信吉祥人寿保险：袁子扬；渤海人寿保险：魏强；深圳中金岭南金汇资本：许统钊；粤港澳大湾区产融投资：何晶；三峡资本：王彦楠；青岛城市建设投资：关忠科；海富通基金：王经纬；国联安基金：侯敏；江西江投：苏荣、万亚平；华菱津杉（天津）产业投资：张福海；江苏民营投资：耿岩；山金金泉（上海）投资：周睿；苏州国信钧翎投资：梁心元；华民股权投资：吴元；上海君怀投资：李遥；国海创新资本：王俊；申银万国投资：韦玮；北京鲲鹏华创投资：王立峰；宁波鹿秀股权投资：宁炜哲；北京太和东方投资：张特；杭州乾璐投资：徐荣正、李翔；上海含德基金：李梦芝；深圳智信创富：叶淼；上海德汇集团：梁天琦；深圳市远致瑞信股权投资：梁辉；上海上国投资：徐昕；南昌金投资本：应云龙；江西大成资本：邹庆伟；广州开发区投资：许汉清；盈科创新：李鹏；广东德汇投资：黄丽敏；深圳市合利私募股权基金：虎麦峰；广州煜健创业投资：王煜；陕西关天资本：蔡嘉驰；重庆渝富资本：邓阳；山东国惠投资：修强；成都立华投资：何艺熙；太平洋保险资管：王喆；财通证券：洪聪颖；中信证券：李建伟。</p>
时间	2022年7月1日
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>通富微电主要从事集成电路封装测试业务，公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司先后在江苏南</p>

通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地；2021 年，公司新增南通市北高新区生产基地。目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面。先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。公司是全球第五大封测企业，市场份额持续提升，行业地位突出。

公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年分别实现营收 72.23 亿元、82.67 亿元、107.69 亿元和 158.12 亿元，2018 年至 2021 年公司营收平均复合增长率 29.85%。公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的归母净利润分别为 1.27 亿元、0.19 亿元、3.38 亿元和 9.57 亿元。2021 年是公司发展历程中浓墨重彩的一年，公司的营收规模和归母净利润均创出历史新高，发展势头强劲。

二、行业情况

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。

根据 IC Insights 今年一月份半导体行业预测，预计 2022 年的半导体总销售额将再增长 11%。中国半导体行业协会发布，2021 年中国集成电路产业销售收入额首次突破万亿大关，达到 10,458.30 亿元，同比增长 18.2%；基于中国半导体产业在多领域实现突破，中国半导体行业协会预计 2022 年产业规模将增至 11,839 亿元。

2020 年，我国半导体自给率仅为 15.9%，距离国家制定“2025 年芯片自给率达到 70%”的目标还有很大空间，随着国产化的进程的不断加快，也必将推动封测需求的进一步增长。

受益于集成电路国产化、智能化、人工智能、物联网、

双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等新技术新需求的落地应用，半导体行业仍处于高景气周期。展望 2022 年，国家支持集成电路产业发展的政策红利会继续得到释放，在强劲有力的国产化需求以及全球新技术革新的推动下，国内封测企业即将迎来更为有利的发展局面。对于有前瞻布局的全产业链公司而言，将迎来更大的发展机遇。

三、公司发展优势

半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。目前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。

公司是全球产品覆盖面最广、技术最全面的封测龙头企业之一。公司面向未来高附加值产品及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势，多个新项目及产品在 2021 年进入量产阶段，并形成新的盈利增长点，各项核心业务实现持续增长。

在技术方面，随着物理瓶颈的出现，摩尔定律越来越难，单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要，先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度，对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。公司凭借多年技术积累及不断研发投入，已具备了 Chiplet 封装的大规模生产能力；在 CPU、GPU、服务器领域立足 7nm，进阶 5nm，目前已实现 5nm 产品的工艺能力和认证，未来将助力 CPU 客户高端进阶；公司先进封装项目荣获“国家科学技术进步一等奖”，该项目突破了高密度高可靠电子封装技术的瓶颈制约，为我国集成电路先进封装技术高端化发展发挥了支撑引领作用。

	<p style="text-align: center;">四、募投项目情况</p> <p>公司拟采用非公开发行股票方式募集不超过 55 亿元资金用于募投项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款。五个生产型募投项目分别为存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G 等新一代通信用产品封装测试项目、圆片级封装类产品扩产项目、功率器件封装测试扩产项目，上述五个生产型募投项目达产后，预计每年新增营收 38 亿元，预计每年新增净利润 4.5 亿元。募投项目均围绕公司主营业务展开，产能释放后公司能够更好的抓住市场发展机遇，满足客户需求，规模优势更加突出，覆盖全面的产品布局与强大的规模化生产能力相得益彰，预计公司的市场竞争力将进一步提升。</p>
附件清单(如有)	—
日期	2022 年 7 月 1 日